

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年4月5日 (2012.4.5)

【公開番号】特開2010-287700(P2010-287700A)

【公開日】平成22年12月24日 (2010.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-051

【出願番号】特願2009-139829(P2009-139829)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

G 0 1 R 31/28 (2006.01)

G 0 1 R 1/06 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/66 B

H 0 1 L 21/66 H

G 0 1 R 31/28 K

G 0 1 R 1/06 E

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月17日 (2012.2.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の工程を含む半導体装置の製造方法：

(a) プローブ検査装置内において、加熱されたウエハステージ上に、被検査ウエハ以外の予備ウエハをロードする工程；

(b) 前記工程 (a) の後、前記予備ウエハを前記ウエハステージ上にロードした状態で、前記ウエハステージの上方のプロブカードの複数のプロブ針を、前記予備ウエハの上面に接触させ、この接触状態を保持したままで、前記プロブカードの予備加熱を実行する工程；

(c) 前記工程 (b) の後、前記予備ウエハの前記上面から前記プロブカードの前記複数のプロブ針を、浮上させる工程；

(d) 前記工程 (c) の後、前記予備ウエハを前記ウエハステージからアンロードする工程；

(e) 前記工程 (d) の後、前記ウエハステージ上に、前記被検査ウエハをそのデバイス面を上に向けた状態でロードする工程；

(f) 前記工程 (e) の後、前記ウエハステージ上にロードされた前記被検査ウエハの前記デバイス面上の複数の電極パッドのそれぞれに、前記複数のプロブ針の内の対応するプロブ針をコンタクトさせた状態で、高温プロブ検査を実行する工程。